

DIN/TS 54405



ICS 83.180

**Konstruktionsklebstoffe –
Leitlinie zum Trennen und Rückgewinnen von Klebstoffen und
Fügeteilen aus geklebten Verbindungen**

Construction adhesives –

Guideline for separation and recycling of adhesives and substrates from bonded joints

Adhésifs de construction –

Lignes directrices pour le décollement et la récupération des adhésifs et des substrats des assemblages collées

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Sicherheit und Umweltschutzgesetze	5
5 Einleitung	6
6 Verfahren	6
6.1 Systematik	6
6.2 Mechanische Verfahren zum Trennen und Rückgewinnen	7
6.2.1 Schneiden	7
6.2.2 Schälen	7
6.2.3 Dehnung des Klebstoffträgers	7
6.2.4 Dehnung der Fügeteile	7
6.3 Physikalische Verfahren zum Trennen und Rückgewinnen	7
6.3.1 Temperatureinwirkung	7
6.3.2 Elektrizität	8
6.3.3 Lösemittel	8
6.4 Chemische Verfahren zum Trennen und Rückgewinnen	8
6.4.1 Bläh- und Treibmittel	8
6.4.2 Zersetzung des Klebstoffs	8
6.4.3 Zersetzung der Fügeteile	8
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Systematik der Haupt- und Untergruppen zum Trennen und Rückgewinnen von Fügeteilen und Klebstoffen aus geklebten Verbindungen	6
---	----------

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-10-02 AA „Prüfmethoden in der konstruktiven Klebtechnik“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) erarbeitet.

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe abgerufen werden;

oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP), 10722 Berlin.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.